

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-04

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>2026年一季报交流会</u> ）
参与单位名称	华创证券有限责任公司 董邦宜；路博迈基金管理（中国）有限公司 张子章；兴业证券股份有限公司 王恬恬；中国国际金融股份有限公司 李澄宁；华泰证券股份有限公司 王心怡；华福证券有限责任公司 郑超君；申万菱信基金管理有限公司 文灿；东方阿尔法基金管理有限公司 朱黎斌；深圳中安汇富私募证券投资基金管理有限公司 朱奕龙；耕霖（上海）投资管理有限公司 张俊龙；贝莱德资产管理北亚有限公司 Christine Shi；国泰海通证券股份有限公司 陈新军；北京枫泉投资管理有限公司 陶静；广发证券股份有限公司 王亮；长城证券股份有限公司 邹兰兰；财通证券股份有限公司 吴姣晨；信达证券股份有限公司 莫文字；广东天贝合资产管理有限公司 黄少波；瑞银证券有限责任公司 罗卿；路博迈亚洲有限公司 肖笛；深圳市凯丰投资管理有限公司 晋奇秀；中国太平保险集团有限责任公司 陈宁玉；泓銘資本金融控股有限公司 李静；深圳昭图投资管理有限公司 王子杰；国联民生证券股份有限公司 李伯语；深圳望正资产管理有限公司 马力；深圳市恒泽私募证券投资基金管理有限公司 叶中正；浙商证券股份有

限公司 胡嘉；江苏羿鹏私募基金管理有限公司 童胜；國泰證券投資信託股份有限公司 楊旻憲；山西證券研究所 李明阳；上海深梧资产管理有限公司 李杰；上海归德私募基金管理有限公司 李纲领；华安财保资产管理有限责任公司 李亚鑫；长安基金管理有限公司 刘嘉；中兵财富资产管理有限责任公司 龙耀华；山西证券股份有限公司 张天；方正富邦基金管理有限公司 冯箫倩；中国人保资产管理有限公司 吴若宗；和谐健康保险股份有限公司 朱之轩；上海毓盛投资管理有限公司 乔旭阳；长信基金管理有限责任公司 陈宇哲；山东鲁创私募投资基金管理有限公司 孙浩喆；国泰海通证券股份有限公司 吴小沛；山西证券股份有限公司 傅盛盛；TIGER PACIFIC CAPITAL LP 田嘉睿；浩成資產管理有限公司 苏怡文；太平洋证券股份有限公司 张世杰；银河基金管理有限公司 孙啸；中原证券股份有限公司 邹臣；锐方(上海)私募基金管理有限公司 褚君；群益证券投资信托股份有限公司 洪玉婷；深圳前海荣金资产管理有限公司 刘瑞奇；摩根大通证券（中国）有限公司 刘叶；安联保险资产管理有限公司 王鹏宇；中银基金管理有限公司 王虹宇；中国国际金融股份有限公司 臧若晨；深圳宽源私募证券基金管理有限公司 庄椀筌；HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited 孙欣；研究所 解承堯；开源证券股份有限公司 张威震；太平资产管理有限公司 马姣；汇丰前海证券有限责任公司 苏增慧；深圳前海宏惟创世资本管理有限公司 谢廷兰；东吴人寿保险股份有限公司 冯佳怡；中国银河证券股份有限公司 刘来珍；上海健顺投资管理有限公司 盛晓君；长城财富保险资产管理股份有限公司 陈苏；Kohler China Investment Co.,

	<p>Ltd. Wendy Wu; 太平洋证券股份有限公司 罗平; CAPITAL LIMITED 张沛然; 湖南源乘私募基金管理有限公司 刘小瑛; 兴业证券股份有限公司 姚康; 发展研究中心电子 莫开寒; 瑞士银行(中国)有限公司 劉帥禹; UBS David Chow; 国盛证券有限责任公司 钟琳; 鹏华基金管理有限公司 闫思倩; 上海十溢投资有限公司 刘绍念; 循远资产管理(上海)有限公司 覃婷; 深圳嘉信天时实业有限公司 刘敏; 嘉实基金管理有限公司 蔡丞丰; 上海十溢投资有限公司 黄健豪;)北京航空航天大学 梁建军; 上海十溢投资有限公司 孙梦云; 合众资产管理股份有限公司 王兴林; 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 张新和; 朱雀基金管理有限公司 张劲骐; 重庆泽栩资产 王林; 华源证券股份有限公司 白宇; 中国人保资产管理有限公司 孙秋波; 国海证券股份有限公司 李晓康; 创金合信基金管理有限公司 王鑫; 上海清淙投资管理有限公司 杨焯; 富瑞金融集團香港有限公司 顏呈宸; 西部证券股份有限公司 李宁宇; 华西证券研究所 赵恒祯; 京明禾投资管理咨询(上海)有限公司 SHARONCHEN; 中信里昂证券(英国) 刘锦东; 富瑞金融 Jacky He (排序不分先后)</p>
时间	2026年04月30日
地点	易董APP/电话会
上市公司接待人员姓名	<p>副总&董秘: 周红</p> <p>IR 主管: 侯琦</p>
	<p>一、 解读公司2026年一季度经营情况</p> <p>2026年一季度, 公司实现总营收79.86亿元, 实现归母净利润4.63亿元, 营收同比呈现微幅回落, 主要系上年同期营收基数较高所致; 归母净利润同比承压, 核心受汇兑损失</p>

**投资者关系活动
主要内容介绍**

及固定资产折旧增加等因素影响，若剔除上述因素干扰，公司经营表现良好。值得关注的是，报告期内公司毛利率水平表现突出，达到22.9%，同比增加5.1个百分点，接近下半年行业旺季时公司毛利率水平。

公司始终聚焦高景气度行业赛道持续深耕布局，不断推进产品结构迭代优化，核心高附加值业务布局成效逐步显现，报告期内，公司汽车及服务器用板营收占比达到11%。

为精准匹配新兴业务发展需求、夯实技术竞争力，公司持续加大研发投入力度，一季度研发投入达7.04亿元，同比增加近2亿元，为前沿产品研发与技术突破提供坚实支撑；与此同时，公司严格管控运营成本，销售费用、管理费用均维持在合理可控区间，整体财务结构保持稳健。

当前，公司新产能建设按既定规划有序推进，核心产品品类正加速扩充产能。随着AI算力产业市场需求持续放量，公司汽车及算力相关用板营收规模将稳步提升，优质业务布局持续驱动经营质量稳步向好，为公司后续经营成长奠定坚实基础。

二、 互动交流

Q1：存储涨价压力下，对大客户供应产品是否有降价压力？Q1 毛利率如何实现快速增长？

答：当前存储产品涨价对行业成本端形成一定压力，但高端产品市场需求表现较好。面对产业链各环节成本上涨趋势，公司积极与上游供应商、下游核心客户协同沟通，共同合理分担成本上涨压力，保障供应链稳定及合作可持续性。报告期内，公司毛利率提升，主因产品结构持续优化，高附加值、高毛利相关产品营收占比稳步提升，有效对冲

部分成本压力，带动整体毛利率水平改善。

Q2：在算力客户方面的进展情况？

答：公司在算力领域的客户拓展与业务推进整体进展顺利，细分领域来看，光模块板块业务增长态势显著，预计今年营收将实现数倍高速增长；同时，公司正稳步推进其它算力产品量产，持续深化该业务布局。

Q3：怎么看待未来几年折旧对公司的影响？

答：公司资本开支投入采用分步投产、分批释放的节奏，对应的固定资产折旧将按照会计准则分阶段确认。同时，公司光模块用板及算力领域的高阶 HDI、HLC 等核心扩产品类，当前市场需求旺盛，产品盈利能力较强，新增产能投产后将能够有效提升公司营收及获利水平。

Q4：鹏鼎在服务器和汽车业务增速快的原因（底层逻辑）？在 AI 领域，要成为主力供应商还需解决哪些问题？

答：公司在服务器领域虽起步稍晚，但早在行业发展初期便深耕 HDI、类载板（SLP）等高精密 PCB 技术，积累了深厚的技术、工艺制造与量产能力，而 AI 服务器对 PCB 的高阶化、高精密化需求，与公司技术优势高度契合，实现了精准技术卡位。产能逐步释放后，凭借领先的技术实力、稳定的产品品质及高效的交付能力，公司有能力强快速获得下游头部客户认可，推动业务高速增长；汽车 PCB 业务则依托公司在高可靠性、高精密 PCB 领域的长期积累，精准匹配新能源汽车、智能汽车对车载 PCB 的严苛要求，叠加客户资源拓展，实现稳健快速增长。

在 AI PCB 领域成为主力供应商，核心在于持续强化研发创新与快速响应能力，能否第一时间匹配 AI 客户迭代速

度快、技术要求高的定制化需求。公司具备三大核心优势：一是多年沉淀的高精密 PCB 技术研发与量产经验，技术壁垒深厚；二是拥有经验丰富、执行力高效的核心管理团队，保障战略落地与业务推进效率；三是具备完善的人才培养体系，同时全面推进 AI 技术在研发、制造、管理等环节的应用，以数字化、智能化赋能业务发展，为成为 AI PCB 重要供应商筑牢基础。

Q5：上游关键设备供应是否会成为扩产瓶颈？

答：公司自成立以来始终秉持“善待供应商”的合作理念，与上游设备、材料供应商建立了长期稳定、深度互信的战略合作关系。从财务数据来看，公司应付账款周转天数长期稳定在 60-70 天，资金支付信誉良好，远优于行业平均水平，因此在供应商产能分配、供货优先级上具备优势。目前公司扩产所需关键设备供应稳定，交付进度符合预期。

Q6：在高阶 HDI 和高多层硬板项目上，未来目标份额展望？新产能投放时，良率爬坡是否会导致毛利率波动？

答：关于市场份额，公司不设定单一量化份额目标，核心聚焦于持续强化研发创新、精细化管理、产品品质管控及成本控制能力，以技术优势与产品竞争力抢占市场，稳步提升在高阶 HDI、高多层硬板领域的市场占有率。其中，细线路高阶 HDI、类载板（SLP）等产品，公司自 2019 年便开始布局，经过多年技术迭代与量产优化，产品良率处于行业领先水平，同时具备成熟、高效的量产爬坡能力。新产能投放阶段，公司凭借成熟的工艺体系、丰富的量产经验，可快速实现良率提升至目标水平，公司对新产品良

	<p>率水平及盈利能力保持充足信心。</p> <p>Q7：研发费用一季度同比增长 37.34%，重点投向哪些前沿科技？</p> <p>答：报告期内公司研发投入主要投向两大核心领域，一是配合 AI 算力行业发展需求，针对 AI 服务器、光模块、数据中心等算力场景，开展高精密、高性能 PCB 新产品的研发设计与工艺优化，深度配合核心客户产品迭代；二是布局 AI 端侧设备市场，研发适配未来 AI 端侧产品对 PCB 轻薄化、高集成化、高传输速率新要求的技术与产品，抢占前沿技术高地，为公司长期发展储备核心技术动能。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了交流与沟通，并严格按照有关制度规定，没有未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 04 月 30 日</p>